

广东生益科技股份有限公司

投资者现场接待日活动会议纪要

一、接待日基本情况：

（一）活动时间：2021年4月7日（周三）14：30~17：30

（二）活动地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号松山湖办事中心二楼阶梯培训室

（三）接待人员：公司董事长刘述峰先生，董事、总经理陈仁喜先生，董事会秘书唐芙云女士

二、接待日主要内容纪要：

（一）公司董事会秘书唐芙云女士主持本次投资者现场接待日活动，对公司2020年度主要情况进行了回顾，并对未来五年的发展规划做了介绍。

（二）问答环节

随后，出席活动的投资者就其关注的行业发展状况、公司战略规划及经营情况等问题与公司董事长，董事、总经理，董事会秘书进行了充分的交流和沟通，主要内容记录如下：

1. 关于近期行业景气度的问题，公司对上半年毛利率趋势、涨价的持续性及终端需求的判断是怎样？

答：总体来说应该不错，因为美国欧洲的疫苗开始见效，各大经济组织判断下半年经济好转，这是个大趋势，在这个趋势下，今年总体来说，市场是没问题。今年跟去年最大的不同是，去年主要靠国内市场，需求情况各异，上半年主要是5G通讯、笔记本电脑，下半年主要是汽车、消费和家电，互补之后，去年总体不错。今年从1月开始，我们整体感觉是各方面都很好，当然伴随最大的问题是原材料大涨，大涨的情况很复杂，我们在去年底已看到这个问题，成为业内行情变化的“吹哨人”。原材料大涨有些是供求关系造成，一是铜箔，几大要素叠加造成大涨，到目前为止这些因素都没有缓和，例如铜矿产量，由于去年疫情影响，造成铜矿减产，经过一年的消耗，他们库存基本消耗完，现在也没有看到大规模复产；电解铜加工费，目前仍然不是理想水平，这些相关因素叠加，造成铜箔缺货，是结构性问题，暂时没有看到这些因素有明显缓和。二是玻璃布，去年底今年初出现缺货，玻璃布厂家由于2019年和2020年的利润不好，开始减产和处理库存，另外风电和工业用玻纤需求好，某些材料做了转产安排，总体来说，从去年底今年初，玻璃布厂家没有库存，议价能力提升，加

上线路板和覆铜板的需求非常好，造成对玻璃布的需求增加。三是化工材料，我们认为理论上是不应该有太大涨价，因为石油和天然气的价格一直在低水平，但是，出现各种意外事件，美国德州雪灾、多家化工厂火灾，国内宣布停产，检修设备。这样，我们三大原材料都在涨价的通道上，目前没看到出现转折。在这个大背景下，线路板和覆铜板的需求非常好，上游材料人为或客观的原因造成的涨价，我们基本处于只能接受的状态，我们也希望通过市场的能力，转移材料涨价成本。市场在上升的通道，虽然原材料涨价，但基本上我们对今年业务有信心。

2. 关于公司长期发展的问题，公司通过产品升级，加大高端材料，抵御行业周期风险，未来五年，公司产品升级的方向和长期目标是怎样？

答：对于未来规划，我们已在安排，目前热门的封装基板，我们也已在分阶段进行，努力把这个项目做好。我们在5个领域追赶标杆企业，未来五年，相信目标是可以实现。

3. 请对比下新的战略规划与以往的战略规划，在产品、市场份额和盈利水平等方面有哪些不同？

答：2021-2025年战略规划与之前战略规划最大的区别是：之前的战略规划是做大做强覆铜板主业，现在这个战略期是做强做大覆铜板主业，我们对“做强”是有定义，包括毛利率、技术、终端需求满足方面等需要达到什么水平，我们要进入世界覆铜板行业的第一阵列，成为举足轻重的供应商，同时，也会扩张产能，大概总量增长30%。

在这个战略期，我们还是坚持不向上下游发展。一方面，如果仅从简单追求成本的角度考虑，可能会进入材料行业，但材料行业的特点，投资大，但产出低，是重资产行业，不符合我们的发展战略。另一方面，随着未来终端产品对材料性能要求越来越高，材料成本就不是唯一考量点了。

4. 公司在做高端产品，离不开供应商支持，包括需要供应商协助开发，请问公司怎样维系与供应商的关系？

答：我们要做强做大覆铜板主业，必须做高端产品，目前高端材料主要掌握在美国、日本和台湾，技术的要求很高，投入大，我们基础和专业积累不够，不大可能涉足高端材料领域。我们最主要的目标是把技术进步的环节，建立在打造坚实、可靠、多样化供应链环节上，保障安全供应。我们很注重打造多元化多渠道供应链体系，主动开发供应商，成立专门机构

开发供应渠道，经过 2 年努力，有一些成果，随着我们主动开发供应链，可以获得更加广泛的供应渠道，对未来获得上游供应商的支持来解决我们的技术问题，很有信心。

5. 子公司未来会扩产，对于它们未来的盈利能力是否也会改善，公司怎样布局？

答：2020 年是集团化元年，我们实行虚拟集团化，重业务、轻管理，重视业务资源整合，为了提升子公司盈利能力，统一市场行动，供应链管理是整体开发和采购，各子公司专注运营成本提升，包括合格率提升和生产成本控制，去年到现在，各子公司持续改善，效果明显，沿着这个思路，不需时日，撇除产品结构的差异，基本上可以处于同等水平。

6. 去年四季度，全行业成本上涨，公司成本控制情况怎样？上游集中在增加，是否影响公司成本控制能力？

答：去年我们很早发现材料在上涨，也想多采购，锁定成本，但供应商的库存基本出清，获得资源有限，总的来说，原材料还在缓慢上升。铜箔厂商在过去几轮的升价，如果撇除铜价提升，主要获利点是加工费，加工费有合理价位。

材料上涨对成本的影响确实很大，例如，去年低点时铜箔加工费是 2.5 美元/公斤，现在上升至 5.8-6 美元/公斤，伦铜上升至 9000 美元，我们的成本上涨很多。供应商议价能力强，供不应求，我们尽量采购需要的量，争取相对优势，没办法取得绝对优势。同时，我们也做客户工作，取得客户理解，平衡短期和长期，如何转移成本的压力，在这之间取得平衡。我们在经营方面有很多优势，最早发现材料上涨的问题，是基于科学分析模型，取得相对优势。

7. 产品组合方面，公司最近几年往高端产品发展，公司选择布局软板的原因是什么，具体的进展怎样？

答：我们在行业中，产品布局最全面，全系列布局，很考验我们的管理水平，要管理好每个系列产品，全方位跟所有同行竞争。

软板在整个行业处于产能供过于求状况，盈利不理想，但为什么需要坚守？因为软板有刚性板所不具备的优势，尤其在将来，当 5G 起来，将迎来软板的爆发性发展，虽然盈利不好，但还是有盈利，我们会继续坚持。

8. 台湾厂商在主推高速板，公司在高速板的进展怎样，包括认证和核心客户？

答：高速材料主要应用于网络通信和服务器，国内的通讯厂商，已通过全系列产品认证，

国外的通讯厂商也通过认证。目前网络通信市场平稳，通过认证已不再是竞争力。服务器领域，以前是陆资公司的短板，在几年前，我们成立台湾生益，主要做服务器产品认证，近两年取得非常大的进展，已通过国内外主流服务器厂商的认证。

9. 封装材料的布局，是基于市场成熟还是技术考虑？是否仅满足国内某些客户的需求？是否有跟日本合作空间？

答：我们跟踪封装基板材料很多年，在十几二十年前瞄准这个方向，那时跟日本某著名公司合作，但由于各种原因，最终没有成功，只能靠我们自己的力量。现在可以量产，每月有一定量的供应，市场和客户已具备，但由于生产技术还需要突破，需要成立新产线，所以，目前没有大量出货。现阶段的经济效益不是重点，我们的目标是在市场占位置，而且，这个产品已通过几家业界知名厂商认证。我们的产品不仅满足国内某些客户的需求，开发的级别包括不同的技术路线，目前进入的是存储领域的芯片封装。之后，我们通过加大研发和技术合作，加大跟产业链上下游的协同，如果在封装基板材料能取得突破，对公司，乃至电子产业的发展有很大促进作用，我们还是很有信心。

10. 目前汽车电子需求很好，价值量有好几倍提升，请问高端汽车产品放量时间点的展望是怎样？

答：我们深耕汽车电子多年，这是我们业务的重要模块，汽车对产品可靠性要求非常高，我们有专门项目小组，包括市场、研发人员，跟踪主要汽车电子产品客户的需求，改善产品性能。管理方面，打造专门的汽车工厂，能生产质量稳定的产品，对产品一致性做到较好的管控。

新能源汽车发展迅猛，我们也抓住机会，汽车有各种用途范围，涵盖所有类型的覆铜板，包括探测距离的高频材料、接收信号的高速材料、高速充放电耐高温高可靠性的大电流材料，控制引擎系统和变速箱，驾驶系统和娱乐系统，挑战难度最大的是毫米波雷达，目前只有一家同行能批量生产，通过努力，我们取得突破，开发出这个产品，也推向了市场，但汽车订单的认证时间长，目前处于大规模认证阶段。未来这块市场起来，我们是不会缺席的，我们对汽车电子化时代充满希望。

11. 公司在 HDI 方面的认证和布局是怎样？服务器方面，公司在权衡投入，主要是考虑成本控制压力问题吗？

答：服务器这类型产品的竞争激烈，服务器是根据英特尔发布的芯片迭代，现在是 Whitley 平台，后续会推出 Eagle Stream 平台，我们也在积极布局认证 Eagle Stream 平台的产品。

HDI 方面，之前碍于我们产能有限，没有作为主力市场去开发，近年来，随着产能的进一步扩大优化，由公司高层牵头成立项目小组，加大对市场的认证、开拓，已取得不错的结果。

12. 公司的研发进行变革，具体是怎样，效果如何？

答：研发改革从 2018 年开始，主要从 6 个方面做改革：研发课题立项、研发经费、研发结果评价、研发组织、研发过程内部成果分享、奖励。例如，研发经费改革，我们实施虚拟核算，项目立项后，有虚拟经费，在研发过程中，每一个单项固定经费，按照虚拟核算做评价，花了多少成本出了多少成果，成果跟投入的比例关系，每个研发人员，在立项时，可以评价投入产出比，比较直观，研发人员会考虑选题方向、内容、投入等。研发评价改革，关注节点进展，对关键节点做评价。奖励改革，设立董事长特别奖，对达到相关标准的，会给予个人及团队重奖。从这两年实施的结果看，效果非常好。

13. 5g 基站后续景气度如何？设备商持续降配，是否对公司高频材料的需求和价格有压力？

答：5g 基站跟运营商投入有关，不是完全的市场行为，我们更加看中广义 5g，在 5g 基础上衍生的大量应用市场。

14. 生益电子未来规划怎样？战略从“做大做强”向“做强做大”调整的原因是什么？如何配套市场布局、资源分配和组织架构？

答：生益电子的未来成长没有问题，目前处在新项目没有发挥作用的过程中，它体量不大，处于扩容期，我们对未来很有信心。

“做大做强”的考虑，通过扩容保持我们在全球覆铜板的地位，主要考虑市场的份额，保持一定的占比，形成市场上有一定话语权。但产能到 1 亿规模，假如简单追求量，结构过于单一，毛利率就不高，我们经过多年的技术积累，具备转型和调整产品结构的条件，调整为“做强做大”，技术上具有一定话语权，进入高端领域，开发高端产品，例如毫米波雷达，这是艰难的挑战。

15. 覆铜板涨价行情，价格传导过程中，公司是受益，原材料价格变化到覆铜板价格变化，定价策略是否有不同？材料在 5 月涨价，公司产品价格涨价 10 月开始，同行 6 月开始涨价？

答：材料供应商不断试探市场接受程度，基本传导周期越来越短，去年 5 月只有通讯比较好，6 月整个行业比较差，6 月材料价格最低，7 月开始缓慢回升，7 月底 8 月初，我们通过供求分析模型，发现了材料价格的变动趋势，对我们后续的产品涨价给到了较好的指引。